日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月30日

出願番号

Application Number:

特願2002-255545

[ST.10/C]:

[JP2002-255545]

出 顧 人
Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 1月24日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-255545

【書類名】 特許願

【整理番号】 A000203827

【提出日】 平成14年 8月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G06F 1/00

【発明の名称】 電子機器

【請求項の数】 15

【発明者】

【住所又は居所】 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会社東芝青梅事

業所内

【氏名】 富岡 健太郎

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研

究開発センター内

【特許出願人】

【識別番号】 000003078

【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】

発熱体を内蔵した筐体と、

上記筐体内に設けられ、上記発熱体に熱的に接続されているとともに冷媒流路 を有した受熱部と、

上記筐体に設けられ、冷媒流路を有した放熱部と、

上記受熱部の冷媒流路と上記放熱部の冷媒流路との間で液状の冷媒を流通する 冷媒管と、を備え、

上記冷媒管の少なくとも一部は、他の部分に比較して、異なる内径、異なる断面形状、あるいは異なる本数の管路を有した異形部を構成していることを特徴とする電子機器。

【請求項2】

発熱体を内蔵した第1筐体と、

上記第1筐体内に設けられ、上記発熱体に熱的に接続されているとともに冷媒 流路を有した受熱部と、

ヒンジ部を介して上記第1筐体に接続された第2筐体と、

上記第2筐体に設けられ、冷媒流路を有した放熱部と、

上記ヒンジ部を通って延びているとともに上記第1筐体と第2筐体との間に跨って配置され、上記受熱部の冷媒流路と上記放熱部の冷媒流路との間で液状の冷媒を流通する冷媒管と、

上記冷媒管の内、上記ヒンジ部を通る部分は、他の部分に比較して、異なる内 径、異なる断面形状、あるいは異なる本数の管路を有した異形部を構成している ことを特徴とする電子機器。

【請求項3】

上記第2筐体は一対のヒンジ部を介して上記第1筐体に支持され、上記冷媒管は、上記受熱部から一方のヒンジ部を通って上記放熱部まで延びた第1冷媒管と、上記放熱部から他方のヒンジ部を通って延びた第2冷媒管とを含み、上記第1

および第2冷媒管はそれぞれ上記異形部を有していることを特徴とする請求項2 に記載の電子機器。

【請求項4】

上記第2筐体は、表示パネルが設けられたディスプレイユニットを構成していることを特徴とする請求項3に記載の電子機器。

【請求項5】

上記異形部は、上記冷媒管の他の部分に比較して、内径の小さな異形冷媒管を 有していることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の電子機器

【請求項6】

上記異形部は、上記冷媒管の他の部分に比較して、それぞれ内径および外径の 小さい複数の並列な異形冷媒管を有していることを特徴とする請求項1ないし4 のいずれか1項に記載の電子機器。

【請求項7】

上記異形部の複数の異形冷媒管は、互いに接合され一体に形成されていること を特徴とする請求項6に記載の電子機器。

【請求項8】

上記異形部の複数の異形冷媒管は、互いに独立して形成されていることを特徴とする請求項6に記載の電子機器。

【請求項9】

上記異形部は、上記冷媒管の他の部分に比較して、外形の大きな異形冷媒管を 有していることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の電子機器

【請求項10】

上記冷媒管は円形の断面形状を有し、上記異形部は、ほぼ楕円形の断面形状を 有した異形冷媒管を有していることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1 項に記載の電子機器。

【請求項11】

上記異形部は、上記冷媒管の他の部分と異なる材料で形成され弾性を有してい

ることを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1項に記載の電子機器。

【請求項12】

上記異形部は、上記冷媒管の他の部分と同一の材料により一体に成形されていることを特徴とする請求項10に記載の電子機器。

【請求項13】

上記冷媒管の他の部分と上記異形部とは管継手により接続されていることを特徴とする請求項1ないし11のいずれか1項に記載の電子機器。

【請求項14】

上記冷媒管の異形部を覆った保護カバーを備えていることを特徴とする請求項 1ないし13のいずれか1項に記載の電子機器。

【請求項15】

上記保護カバーは、第1筐体、第2筐体、あるいは筐体に固定されていること を特徴とする請求項14に記載の電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体パッケージのような発熱体を内蔵した電子機器に係り、特にその発熱体の冷却性能を高めるための冷却構造を備えた電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】

ノート形のポータブルコンピュータや移動体通信機器に代表される携帯形の電子機器は、マルチメディア情報を処理するためのマイクロプロセッサを装備している。この種のマイクロプロセッサは、処理速度の高速化や多機能化に伴って動作中の発熱量が急速に増大する傾向にある。そのため、マイクロプロセッサの安定した動作を保障するためには、このマイクロプロセッサの放熱性を高める必要がある。

[0003]

この熱対策として、従来の電子機器は、マイクロプロセッサを強制的に冷却する空冷式の冷却装置を装備している。この冷却装置は、マイクロプロセッサの熱

を奪って放散させるヒートシンクと、このヒートシンクに冷却風を送風する電動 ファンとを備えている。

[0004]

ヒートシンクは、マイクロプロセッサの熱を受ける受熱部、複数の放熱フィンおよび冷却風通路を有している。冷却風通路は、受熱部や放熱フィンに沿うように形成されており、この冷却風通路に電動ファンを介して冷却風が送風される。冷却風は、放熱フィンの間を縫うようにして流れ、この流れの過程でヒートシンクを強制的に冷却する。そのため、ヒートシンクに伝えられたマイクロプロセッサの熱は、冷却風の流れに乗じて持ち去られるとともに、冷却風通路の下流端から電子機器の外部に排出されるようになっている。

[0005]

この従来の冷却方式では、冷却風通路を流れる冷却風がマイクロプロセッサの 熱を奪う冷却媒体となるため、マイクロプロセッサの冷却性能の多くは、冷却風 の風量やこの冷却風とヒートシンクとの接触面積に依存することになる。

[0006]

ところが、マイクロプロセッサの冷却性能を高めることを意図して冷却風の風量を増やすと、電動ファンの回転数が増大し、大きな騒音を発するといった問題がある。また、放熱フィンの数を増やしたり、形状を大きくした場合には、ヒートシンク自体が巨大なものとなる。そのため、電子機器の内部にヒートシンクを収める広い設置スペースを確保しなくてはならず、ポータブルコンピュータのような小型の電子機器にはスペース的な問題から適用することができない。

[0007]

近い将来、電子機器用のマイクロプロセッサは、更なる高速化や多機能化が予測され、それに伴いマイクロプロセッサの発熱量も飛躍的な増加が見込まれる。 したがって、従来の強制空冷による冷却方式では、マイクロプロセッサの冷却性能が不足したり限界に達することが懸念される。

[0008]

これを改善するものとして、例えば「特開平7-143886号公報」に見られるように、空気よりも遥かに高い比熱を有する液体を冷媒として利用し、マイ

クロプロセッサの冷却効率を高めようとする、いわゆる液冷による冷却方式が試 されている。

[0009]

この新たな冷却方式では、マイクロプロセッサが収容された筐体の内部に受熱 ヘッダを設置するとともに、この筐体に支持されたディスプレイユニットの内部 に放熱ヘッダを設置している。受熱ヘッダは、マクロプロセッサに熱的に接続されており、この受熱ヘッダの内部に液状の冷媒が流れる流路が形成されている。 放熱ヘッダは、ディスプレイユニットに熱的に接続されており、この放熱ヘッダ の内部にも上記冷媒が流れる流路が形成されている。そして、これら受熱ヘッダ の流路と放熱ヘッダの流路とは、冷媒を循環させる循環経路を介して互いに接続 されている。

[0010]

この冷却方式によると、マイクロプロセッサの熱は、受熱ヘッダから冷媒に伝えられた後、この冷媒の流れに乗じて放熱ヘッダに移送される。放熱ヘッダに移された熱は、冷媒が流路を流れる過程で熱伝導により拡散され、この放熱ヘッダからディスプレイユニットを通じて大気中に放出される。

[0011]

そのため、マイクロプロセッサの熱を冷媒の流れを利用して効率良くディスプレイユニットに移送することができ、従来の強制空冷に比べてマイクロプロセッサの冷却性能を高めることができるとともに、騒音面でも何ら問題は生じないといった優位点がある。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

上述した構成の冷却方式を電子機器として、例えば特開平7-143886号公報に開示されているようなノート形のポータブルコンピュータに適用した場合、ディスプレイユニットは筐体に対しヒンジ部により回動自在に支持されているため、冷媒管路は、ヒンジ部を通って筐体とディスプレイユニットとの間を延びた構造となる。そして、冷媒管路がヒンジ部を通る構成では、ディスプレイユニットの開閉動作に伴い、冷媒管路が捩れて潰れ、あるいは、冷媒管路が周囲の構

成部材に接触して磨耗あるいは損傷を受ける恐れがある。

[0013]

上記のように冷媒管路が潰れた場合、冷媒の流通が阻害され冷却効率の低下、 あるいは、最悪の場合、冷却が困難となる。また、冷媒管路が磨耗、損傷した場 合、冷媒が漏洩し冷却能力が失われてしまう。

[0014]

この発明は、以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、冷媒管路の潰れ、損傷等を防止し、発熱体を安定して冷却可能な電子機器を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、この発明の態様に係る電子機器は、発熱体を内蔵した筐体と、上記筐体内に設けられ、上記発熱体に熱的に接続されているとともに冷媒流路を有した受熱部と、上記筐体に設けられ、冷媒流路を有した放熱部と、上記受熱部の冷媒流路と上記放熱部の冷媒流路との間で液状の冷媒を流通する冷媒管と、を備え、上記冷媒管の少なくとも一部は、他の部分に比較して、異なる内径、異なる断面形状、あるいは異なる本数の管路を有した異形部を構成していることを特徴としている。

[0016]

また、この発明の他の態様に係る電子機器は、発熱体を内蔵した第1筐体と、 上記第1筐体内に設けられ、上記発熱体に熱的に接続されているとともに冷媒流路を有した受熱部と、ヒンジ部を介して上記第1筐体に接続された第2筐体と、 上記第2筐体に設けられ、冷媒流路を有した放熱部と、上記ヒンジ部を通って延びているとともに上記第1筐体と第2筐体との間に跨って配置され、上記受熱部の冷媒流路と上記放熱部の冷媒流路との間で液状の冷媒を流通する冷媒管と、上記冷媒管の内、上記ヒンジ部を通る部分は、他の部分に比較して、異なる内径、 異なる断面形状、あるいは異なる本数の管路を有した異形部を構成していることを特徴としている。

[0017]

上記のように構成された電子機器によれば、冷媒管の少なくとも一部を、他の

部分に比較して、異なる内径、異なる断面形状、あるいは異なる本数の管路を有 した異形部で構成することにより、この異形部が捩じれた場合でも、冷媒管の潰 れ、損傷を防止し、確実な冷媒の流通を確保することができる。これにより、発 熱体を安定して冷却可能な電子機器を提供することができる。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下図面を参照しながら、この発明に係る電子機器をポータブルコンピュータ に適用した実施の形態について詳細に説明する。

図1ないし図3に示すように、ポータブルコンピュータ1は機器本体2と、表示ユニット3とを備えている。機器本体2は、偏平な箱形の第1筐体4を含んでいる。第1筐体4は、底壁4a、上壁4b、前壁4c、左右の側壁4dおよび後壁4eを備えている。上壁4bには、キーボード5が設けられている。さらに、上壁4bは、キーボード5の背後にディスプレイ支持部6を有している。ディスプレイ支持部6は、上壁4bの後端部から上向きに張り出すとともに、第1筐体4の幅方向に延びている。ディスプレイ支持部6は、第1筐体4の幅方向に互いに離間した一対の凹部7a,7bを有している。

[0019]

表示ユニット3は、液晶表示パネル10と、偏平な箱形の第2筐体11とを備えている。液晶表示パネル10は、その前面に画像を表示する画面10aを有している。第2筐体11は、開口部12が形成された前壁13、後壁14および四つの側壁15とを有している。後壁14は、前壁13や開口部12と向かい合っている。前壁13、後壁14および側壁15は、液晶表示パネル10を取り囲んでいる。液晶表示パネル10の画面10aは、開口部12を通じて第2筐体11の外方に露出されている。なお、第1筐体4および第2筐体11は、この発明における筐体を構成している。

[0020]

第2筐体11は、その一端部から突出する一対の脚部16a,16bを有している。脚部16a,16bは、中空状をなすとともに、第2筐体11の幅方向に互いに離間している。これら脚部16a,16bは、第1筐体4の凹部7a,7

bに挿入されているとともに、図示しないヒンジ装置を介して第1筐体4に連結され、ヒンジ部17a、17bを構成している。

[0021]

そのため、表示ユニット3は、キーボード5を上方から覆うように倒される閉じ位置と、キーボード5や画面10aを露出させるように起立する開き位置とに亘って回動可能に、機器本体2に支持されている。

[0022]

図2および図3に示すように、第1筐体4は、プリント配線板18、パック状機器としてのハードディスク駆動装置19およびCD-ROM駆動装置20を収容している。プリント配線板18、ハードディスク駆動装置19およびCD-ROM駆動装置20は、第1筐体4の底壁4aの上に並べて配置されている。

[0023]

図4に示すように、プリント配線板18の上面には、発熱体としての半導体パッケージ21が実装されている。半導体パッケージ21は、ポータブルコンピュータ1の中枢となるマイクロプロセッサを構成するものであり、プリント配線板18の後部に位置されている。半導体パッケージ21は、ベース基板22と、このベース基板22の上面の中央部に配置されたICチップ23とを有している。ICチップ23は、処理速度の高速化や多機能化に伴って動作中の発熱量が非常に大きく、安定した動作を維持するために冷却を必要としている。

[0024]

図2および図3に示すように、ポータブルコンピュータ1は、半導体パッケージ21を冷却する液冷式の冷却ユニット25を搭載している。冷却ユニット25は、受熱部として機能する受熱ヘッド26、放熱部として機能する放熱器27、循環経路28、電動ファン29、および遠心ポンプ53を備えている。

[0025]

受熱ヘッド26は、第1筐体4に収容されている。図4および図5に最も良く示されるように、受熱ヘッド26は、偏平な箱形であり、プリント配線板18の上面に複数のねじを介して固定されている。受熱ヘッド26は、半導体パッケージ21よりも一回り大きな平面形状を有している。受熱ヘッド26の下面は、平

坦な受熱面30となっている。受熱面30は、図示しない熱伝導性グリース又は 熱伝導シートを介して半導体パッケージ21のICチップ23に熱的に接続され ている。

[0026]

さらに、受熱ヘッド26の内部には冷媒流路31が形成されている。冷媒流路31は、受熱面30を介してICチップ23に熱的に接続されているとともに、複数のガイド壁32によって複数のセクション33に仕切られている。また、受熱ヘッド26は、冷媒入口34と冷媒出口35とを有している。冷媒入口34は、冷媒流路31の上流端に位置し、冷媒出口35は、冷媒流路31の下流端に位置している。

[0027]

図2、図3および図6に示すように、放熱器27は、第2筐体11に収容され、第2筐体11の後壁14と液晶表示パネル10との間に介在されている。放熱器27は、後壁14と略同等の大きさを有する長方形の板状をなしている。図8に示すように、放熱器27は、第1放熱板37と第2放熱板38とを備えている。第1および第2放熱板37、38は、例えばアルミニウム合金のような熱伝導性に優れた金属材料にて構成されている。これら第1および第2放熱板37、38は、互いに重ね合わせて圧着されている。

[0028]

第1放熱板37は、第2放熱板38の反対側に張り出すように膨らんだ多数の 膨出部39を有している。膨出部39は、第1放熱板37の略全面に亘って蛇行 状に形成されているとともに、第2放熱板38との合面に開口されている。この 膨出部39の開口端は、第2放熱板38によって閉じられている。そのため、第 1放熱板37の膨出部39は、第2放熱板38との間に冷媒流路40を構成して いる。冷媒流路40は、第2筐体11の幅方向に延びる複数の直管部41を有し 、これら直管部41は、第2筐体11の高さ方向に間隔を存して互いに平行に配 置されている。

[0029]

放熱器27は、冷媒入口42と冷媒出口43とを有している。冷媒入口42は

、冷媒流路40の上流端に連なっている。この冷媒入口42は、放熱器27の左端部に位置されているとともに、第2筐体11の左側の脚部16aに隣接している。冷媒出口43は、冷媒流路40の下流端に連なっている。この冷媒出口43は、放熱器27の右端部に位置しているとともに、第2筐体11の右側の脚部16bに隣接している。このため、冷媒入口42と冷媒出口43とは、第2筐体11の幅方向に互いに離れている。

[0030]

膨出部39を有する第1放熱板37は、第2筐体11の後壁14と向かい合っている。この第1放熱板37の膨出部39と後壁14との間には、僅かな隙間が形成されている。

[0031]

放熱器 2 7 の第 2 放熱板 3 8 は、液晶表示パネル 1 0 と向かい合っている。これら第 2 放熱板 3 8 と液晶表示パネル 1 0 との間に冷却風通路 4 6 が形成されている。第 2 放熱板 3 8 に複数の放熱用のフィン 4 7 が取り付けられている。各フィン 4 7 は、第 2 放熱板 3 8 とは別のアルミ板にて構成され、上記冷却風通路 4 6 に露出されている。フィン 4 7 は、細長い板状であり、その一側縁に直角に折り返された立ち上がり部 4 7 a を有している。フィン 4 7 は、第 2 放熱板 3 8 に接着されて、この第 2 放熱板 3 8 に熱的に接続されている。これらフィン 4 7 は、表示ユニット 3 の高さ方向に延びるとともに、この表示ユニット 3 の幅方向に間隔を存して互いに平行に配置されている。

[0032]

冷却風通路46およびフィン47は、表示ユニット3を上記開き位置に回動させた時に、表示ユニット3に沿って縦方向に延びている。この際、フィン47の上端は、第2筐体11の上端に位置された一つの側壁15と向かい合っている。図1、図3および図6に示すように、側壁15は、複数の排気口48を有している。これら排気口48は、表示ユニット3が上記開き位置にある限り、冷却風通路46の上端に位置されている。

[0033]

電動ファン29は、放熱器27に冷却風を強制的に送風するためのものであり

、第2筐体11に収容されている。電動ファン29は、放熱器27の切り欠き54に入り込んでいる。また、電動ファン29は、遠心式の羽根車57と、この羽根車57を収容するファンケーシング58とを備えている。羽根車57は、例えば半導体パッケージ21の温度が予め決められた値に達した時に、図示しないモータによって駆動される。ファンケーシング58は、偏平な箱形であり、第2筐体11の前壁13と後壁14との間に介在されている。

[0034]

ファンケーシング58は、第1および第2吸込口60a,60bと吐出口61とを有している。第1および第2吸込口60a,60bは、羽根車57を間に挟んで同軸状に配置されている。第1吸込口60aは、前壁13に開口された複数の第1吸気孔65と向かい合っている。第2吸込口60bは、後壁14に開口された複数の第2吸気孔63と向かい合っている。吐出口61は、第2筐体11の内部において、その右側方を指向するように開口されている。

[0035]

電動ファン29は、表示ユニット3を上記開き位置に回動させた時に、放熱器27の下端部に位置されている。そのため、ファンケーシング58の吐出口61は、表示ユニット3が開き位置にある限り、上記フィン47の下端よりも下方に位置されている。

[0036]

図2および図3に示すように、冷却ユニット25の循環経路28は、第1冷媒管50と第2冷媒管51とを備えている。第1および第2冷媒管50,51は、第1筐体4と第2筐体11との間に跨っている。

[0037]

第1冷媒管50は、一方のヒンジ部17aを通り、受熱ヘッド26の冷媒出口35と放熱器27の冷媒入口42とを接続している。第1冷媒管50は、上流部50a、下流部50bおよび異形部50cとを含んでいる。第1冷媒管50の上流部50aは、受熱ヘッド26の冷媒出口35に接続されて、第1筐体4に収められている。第1冷媒管50の下流部50bは、放熱器27の冷媒入口42に接続されて、第2筐体11の左端部に収められている。異形部50cは、上流部5

0 a と下流部 5 0 b とを接続している。この異形部 5 0 c は、ヒンジ部 1 7 a において、凹部 7 a と脚部 1 6 a とを貫通して延びているとともに、表示ユニット 3 の回動中心線上に位置されている。

[0038]

図3、図9および図10に示すように、第1冷媒管50の上流部50aおよび下流部50bは、例えば、アルミニウム等の金属からなる同一径の冷媒管により構成されている。上流部50aおよび下流部50b間に接続された異形部50cは、上流部50aおよび下流部50bを構成する冷媒管よりも、それぞれ内径および外径の小さい複数本の異形冷媒管、例えば3本の異形冷媒管55を有している。これらの異形冷媒管55は並列に設けられ、各異形冷媒管の両端はそれぞれ管継手62により上流部50aおよび下流部50bに接続されている。

[0039]

また、異形冷媒管 5 5 は、他の冷媒管と異なる材料により形成されている。ここでは、異形冷媒管 5 5 は、例えば、ブチルゴムチューブ、シリコンチューブ、あるいはテフロン(商標)チューブ等の弾性を有するフレキシブルなチューブにより構成されている。なお、第 1 冷媒管 5 0 の上流部 5 0 a および下流部 5 0 b は、金属に限らず、異形冷媒管 5 5 と同一の材料で形成してもよい。

[0040]

更に、第1冷媒管50の異形部50cは、例えば、合成樹脂により形成された 円筒状の保護カバー64により覆われている。保護カバー64は、上流部50a および下流部50bよりも大きな径を有し、筐体、例えば、第1筐体4に固定さ れ、ヒンジ部17aの凹部7aおよび脚部16aを貫通して延びている。

[0041]

一方、第2冷媒管51は、他方のヒンジ部17bを通り、放熱器27の冷媒出口43と受熱ヘッド26の冷媒入口34とを接続している。第2冷媒管51は、上流部51a、下流部51bおよび異形部51cとを含んでいる。第2冷媒管51の上流部51aは、放熱器27の冷媒出口43に接続されて、第2筐体11の右端部に収められている。第2冷媒管51の下流部51bは、受熱ヘッド26の冷媒入口34に接続され、第1筐体4に収められている。異形部51cは、上流

部51 a と下流部51 b とを接続している。この異形部51 c は、ヒンジ部17 b において、凹部7 b と脚部16 b とを貫通して延びているとともに、表示ユニット3の回動中心線上に位置されている。

[0042]

なお、第2冷媒管51の上流部51a、下流部51b、および異形部51cは、第1冷媒管50の上流部50a、下流部50b、異形部50cとそれぞれ同様に構成されている。すなわち、上流部51aおよび下流部51bは、それぞれ例えば、アルミニウム等の金属からなる同一径の冷媒管により構成されている。異形部51cは、上流部51aおよび下流部51bを構成する冷媒管よりも、それぞれ内径および外径の小さい例えば3本の異形冷媒管55を有している。これらの異形冷媒管55は並列に設けられ、各異形冷媒管の両端はそれぞれ管継手62により上流部50aおよび下流部50bに接続されている。また、異形部51cは、保護カバー64により覆われている。

[0043]

上記冷却ユニット25において、受熱ヘッド26の冷媒流路31、放熱器27 の冷媒流路40および循環経路28には、液状の冷媒としての冷却液が封入され ている。冷却液としては、例えば水にエチレングリコール溶液および必要に応じ て腐蝕防止剤を添加した不凍液が用いられる。

[0044]

図2および図3に示すように、循環経路28は、循環手段として、例えば小型の遠心ポンプ53を含んでいる。遠心ポンプ53は、上記冷却液を受熱ヘッド26と放熱器27との間で強制的に循環させるためのものである。遠心ポンプ53は、第2冷媒管50の下流部51bの中途部に接続され、第1筐体4内に配設されている。この遠心ポンプ53は、例えばポータブルコンピュータ1の電源投入時あるいは半導体パッケージ21の温度が予め決められた値に達した時に駆動される。

[0045]

上記のように構成されたポータブルコンピュータ1において、半導体パッケージ21のICチップ23は、ポータブルコンピュータ1の使用中に発熱する。こ

のICチップ23の熱は、受熱ヘッド26の受熱面30に伝えられる。受熱ヘッド26は、冷却液が封入された冷媒流路31を有するので、受熱面30に伝えられた熱の多くを冷却液が吸収する。

[0046]

半導体パッケージ21の温度が規定値に達すると、遠心ポンプ53が駆動を開始する。これにより冷却液が受熱ヘッド26から放熱器27に向けて圧送され、受熱ヘッド26の冷媒流路31と放熱器27の冷媒流路40との間で冷却液が強制的に循環される。

[0047]

すなわち、受熱ヘッド26での熱交換により加熱された冷却液は、遠心ポンプ53の加圧により、第1冷媒管50を通じて放熱器27に導かれる。そして、冷却液は、蛇行状に屈曲された長い冷媒流路40を冷媒入口42から冷媒出口43に向けて流れる。この流れの過程で冷却液に吸収されたICチップ23の熱が第1および第2放熱板37,38に拡散され、放熱器27の表面から第2筐体11内に放出される。

[0048]

それとともに、放熱器27に拡散された熱の一部は、第2放熱板38からフィン47に伝わり、これらフィン47の表面から冷却風通路46に放出される。この結果、熱くなった冷却液が放熱器27での熱交換により冷やされる。

[0049]

さらに、半導体パッケージ21の温度が規定値に達した時点で、電動ファン29が駆動を開始する。電動ファン29の羽根車57が回転すると、図6に矢印で示すように、表示ユニット3の外部の空気が第2筐体11の吸気孔65,63からファンケーシング58の吸込口60a、60bに吸い込まれる。この吸い込まれた空気は、羽根車57の外周部から吐き出されるとともに、ファンケーシング58の吐出口61から放熱器27に向けて放出される。

[0050]

これにより、第2筐体11の内部に冷却風の流れが形成される。この冷却風は、図3および図6に矢印で示すように、冷却風通路46を下から上に向けて流れ

、フィン47の間を通り抜ける過程で放熱器27を強制的に冷却する。このため、放熱器27に伝えられたICチップ23の熱は、冷却風の流れに乗じて持ち去られる。放熱器27との熱交換により暖められた冷却風は、第2筐体11の上端の排気口48を通じて表示ユニット3の外部に排出される。

[0051]

放熱器 2 7 を通過する過程で冷やされた冷却液は、第 2 冷媒管 5 1 を通じて受熱ヘッド 2 6 の冷媒流路 3 1 に戻される。この冷却液は、冷媒流路 3 1 を流れる過程で再び I C チップ 2 3 の熱を吸収した後、放熱器 2 7 に導かれる。このようなサイクルを繰り返すことで、I C チップ 2 3 の熱が表示ユニット 3 を通じてポータブルコンピュータ 1 の外部に放出される。

[0052]

このような構成によれば、表示ユニット3の第2筐体11の内部に放熱器27を収容し、この放熱器27と半導体パッケージ21の熱を受ける受熱ヘッド26との間で液状の冷媒を循環させるようにしたので、この冷媒の流れを利用して半導体パッケージ21の熱を効率良く表示ユニット3に移送して、ここから大気中に放出することができる。このため、従来一般的な強制空冷との比較において、半導体パッケージ21の放熱性能を飛躍的に高めることができる。

[0053]

また、上述した実施の形態によれば、冷却ユニット25の冷媒管の内、ポータブルコンピュータ1の可動部を通る部分、すなわち、ヒンジ部17a、17bを通る部分は、異形部50c、51cとして構成されている。そして、各異形部50c、51cは、他の冷媒管よりも外形および内径の小さい異形冷媒管55を複数本並列に並べて構成されている。また、本実施の形態において、これらの異形冷媒管55は弾性を有する材料により形成されフレキシブルとなっている。そのため、表示ユニット3の開閉動作に伴い、冷媒管の異形部50c、51cが捩じれた場合でも、冷媒管の潰れを防止し、確実な冷却液の流通を確保することができる。

[0054]

すなわち、内径および外径の小さな異形冷媒管55は、大径の他の冷媒管に比

較して、径に対する壁厚の割合が多く、管自体の強度が向上する。そのため、捩れによる潰れが低減する。径を細くすることにより、異形冷媒管55はヒンジ部17a、17bに通し易く、かつ、周囲の部材に接触しにくくすることができる。これにより、異形冷媒管55の磨耗や傷付きを防止し、冷却液の漏洩を防止することが可能となる。また、異形部50c、51cを保護カバー64で覆うことにより、異形冷媒管55の磨耗、損傷を一層確実に防止することができる。更に、径を細くした場合でも、異形冷媒管55を複数本並列に配置して他の冷媒管に接続することにより、冷却液の流量の低減および流通抵抗の増大を防止し、冷却液の円滑な流通を維持することができる。

[0055]

以上のことから、ポータブルコンピュータ1の可動部を通して冷却ユニット2 5の冷媒管を配置した場合でも、冷媒管路の潰れ、損傷等を防止し、安定した冷却能力を発揮可能することが可能となる。

[0056]

なお、本発明は上記第1の実施の形態に特定されるものではなく、この発明の 範囲内で種々変形可能である。例えば、循環経路28を構成する冷媒管の異形部 は、可動部としてポータブルコンピュータ1のヒンジ部を通過する部分に設ける 構成としたが、これに限らず、異形部は、他の可動部に設けられていてもよい。 また、冷媒管の異形部は、可動部に限らず、大きな曲率で冷媒管を湾曲あるいは 屈曲する部分に設けてもよく、この場合においても、冷媒管の潰れを低減し冷媒 の円滑な流通を確保することが可能となる。

[0057]

図11および図12に示す第2の実施の形態によれば、冷却ユニットにおいて、第1冷媒管50の異形部50cは、複数本、例えば、3本の異形冷媒管55を有している。これらの異形冷媒管55は一体に成形され、互いに並列に延びている。第2冷媒管51の異形部51cも異形部50cと同様に構成されている。このような構成においても、上記第1の実施の形態と同様の作用効果を得ることができる。更に、第2の実施の形態によれば、複数の異形冷媒管55が一体に成形されているため、異形部全体としての強度が向上し潰れ難くなるとともに、組立

て作業が容易となる。

[0058]

図13に示す第3の実施の形態によれば、冷却ユニットにおいて、第1冷媒管50の異形部50cは、上流部50aおよび下流部50bを構成する冷媒管と異なる断面形状を有した異形冷媒管55により構成されている。ここでは、上流部50aおよび下流部50bを構成する冷媒管が円形の断面形状を有しているのに対し、異形冷媒管55は楕円の断面形状を有している。そして、楕円断面の長軸径は、上流部および下流部の径よりも小さく形成されている。第2冷媒管51の異形部51cも異形部50cと同様に構成されている。

[0059]

このように異形冷媒管 5 5 を楕円断面形状とした場合、異形冷媒管 5 5 をヒンジ部等の細い部分に容易に通すことができるとともに、捩れに対する強度が向上し潰れ難くすることが可能となる。

[0060]

図14に示す第4の実施の形態によれば、冷却ユニットにおいて、第1冷媒管50の異形部50cは、上流部50aおよび下流部50bを構成する冷媒管の内径よりも大きな内径を有する異形冷媒管55により構成されている。第2冷媒管51の異形部51cも異形部50cと同様に構成されている。

[0061]

このように内径の大きな異形冷媒管 5 5 を用いることにより、異形冷媒管が振れ多少潰れた場合でも流通路を確保することができ、冷却液を円滑に流通することができる。異形冷媒管 5 5 の外径を他の冷媒管の外径よりも大きくし、かつ、内径を他の冷媒管とほぼ共通としてもよい。この場合、異形冷媒管 5 5 の壁厚が厚くなり、異形冷媒管 5 5 の捩れに対する強度が向上し潰れ難くすることが可能となる。

[0062]

なお、上述した第2ないし第4の実施の形態において、他の構成は前述した第 1の実施の形態と同一であり、同一の部分には同一の参照符号を付してその詳細 な説明を省略する。

[0063]

その他、上述した実施の形態では、異形冷媒管および他の冷媒管を別体に形成 し、管継手により接続する構成としてが、異形冷媒管および他の冷媒管を共通の 材料で一体に成形しても良い。

[0064]

また、この発明はポータブルコンピュータに限らず、他の電子機器にも適用可能である。また、冷却ユニットを構成する各構成要素の配設位置は、上述した実施の形態に限らず、必要に応じて変更可能である。例えば、遠心ポンプは、第2筐体内に設けてもよい。また、放熱器は、第2筐体に限らず、受熱部と共に第1筐体内に設けることも可能である。

[0065]

【発明の効果】

以上詳述したように、本発明によれば、冷媒管路の潰れ、損傷等を防止し、冷 媒を円滑に流通することができ、発熱体を安定して冷却可能な電子機器を提供す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

表示ユニットを開き位置に回動させた状態におけるこの発明の第1の実施の形態に係るポータブルコンピュータを示す斜視図。

【図2】

上記ポータブルコンピュータにおける受熱ヘッド、放熱器、遠心ポンプを有する循環経路および電動ファンの位置関係を概略的に示す斜視図。

【図3】

上記ポータブルコンピュータにおける受熱ヘッド、放熱器、遠心ポンプを有す る循環経路および電動ファンの位置関係を示す断面図。

【図4】

上記ポータブルコンピュータにおける半導体パッケージと受熱ヘッドとの位置 関係を示す断面図。 【図5】

上記ポータブルコンピュータにおいて、半導体パッケージに熱的に接続された 受熱ヘッドを示す断面図。

【図6】

上記ポータブルコンピュータにおいて、電動ファンと第2筐体の吸気孔との位置関係を示す断面図。

【図7】

上記ポータブルコンピュータにおけるフィンの構成を示す断面図。

【図8】

上記ポータブルコンピュータにおける放熱器の構成を示す断面図。

【図9】

上記ポータブルコンピュータの冷却液の循環経路における異形部の構成を示す 断面図。

【図10】

上記異形部を示す斜視図。

【図11】

この発明の第2の実施の形態における異形部の構成を示す斜視図。

【図12】

図11の線A-Aに沿った異形部の断面図。

【図13】

この発明の第3の実施の形態における異形部の構成を示す斜視図。

【図14】

この発明の第4の実施の形態における異形部の構成を示す斜視図。

【符号の説明】

- 2…機器本体
- 3 …表示ユニット
- 4 … 第 1 筐体
- 10…表示パネル(液晶表示パネル)
- 11…第2筐体

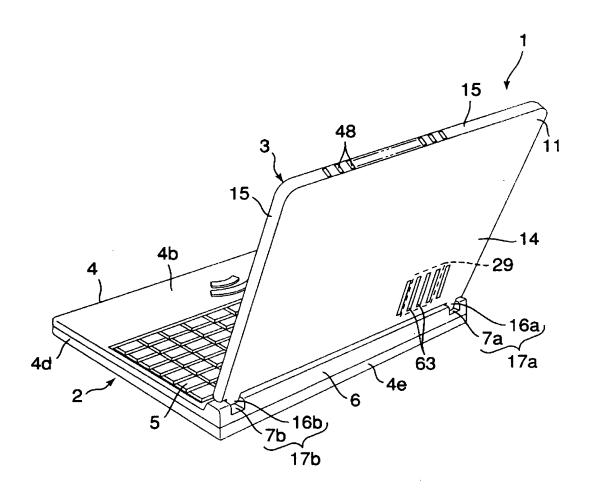
特2002-255545

- 17a、17b…ヒンジ部
- 21…発熱体(半導体パッケージ)
- 26…受熱部(受熱ヘッド)
- 27…放熱部(放熱器)
- 28…循環経路
- 29…ファン(電動ファン)
- 31,71,83…冷媒流路
- 40,71,83…冷媒流路
- 50…第1冷媒管
- 51…第2冷媒管
- 50c、51c…異形部
- 55…異形冷媒管
- 6 2 …管継手
- 64…保護カバー

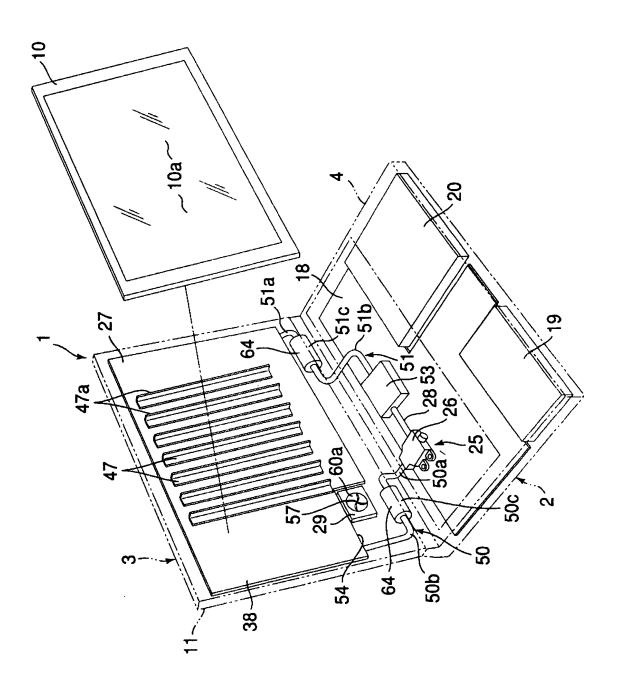
【書類名】

図面

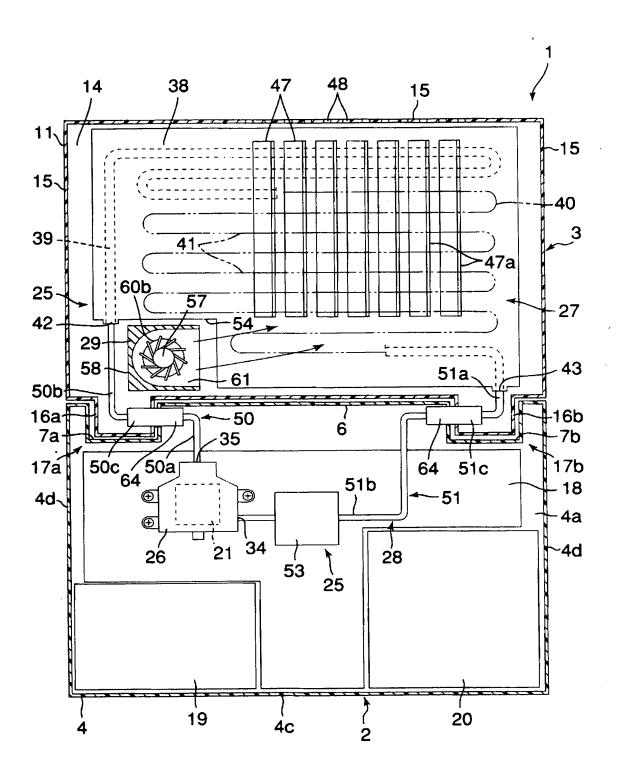
【図1】



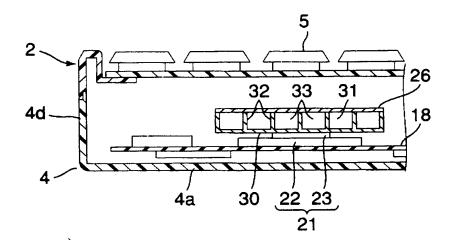
【図2】



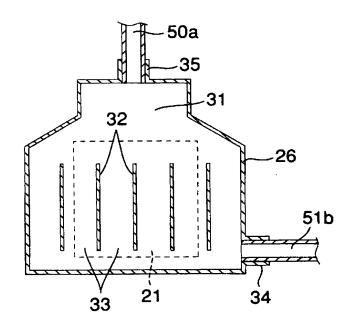
【図3】



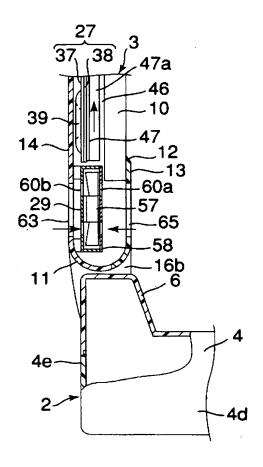
【図4】



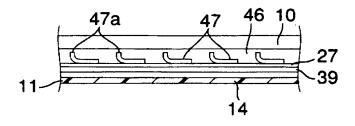
【図5】



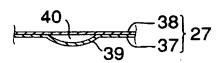
【図6】



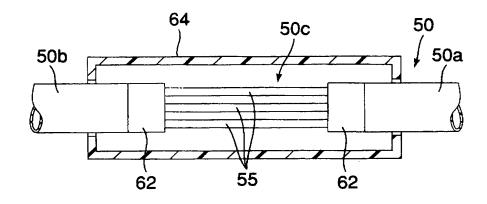
【図7】



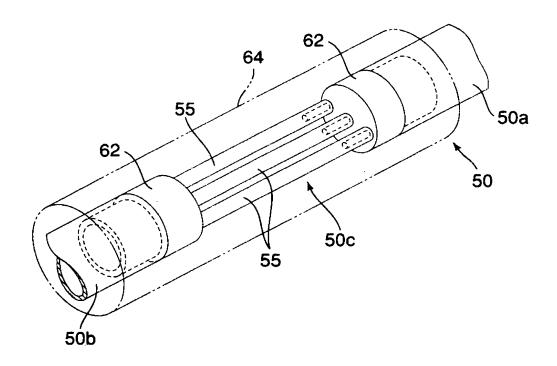
【図8】



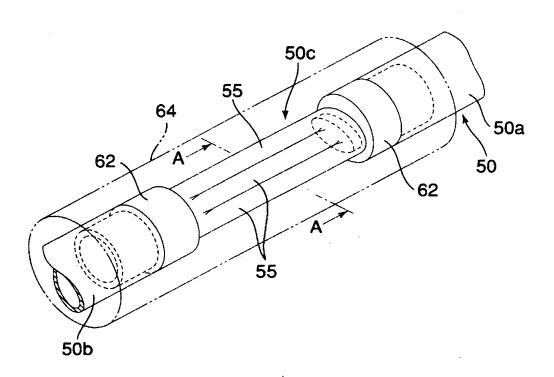
【図9】



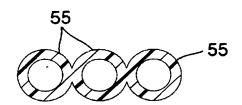
【図10】



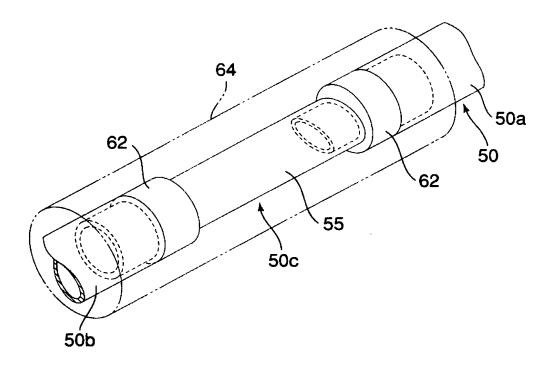
【図11】



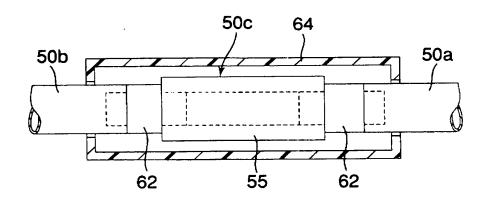
【図12】



【図13】



【図14】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】冷媒管路の潰れ、損傷等を防止し、発熱体を安定して冷却可能な電子機器を提供する。

【解決手段】 電子機器の冷却ユニットは、発熱体を内蔵した筐体と、筐体内に設けられ発熱体に熱的に接続されているとともに冷媒流路を有した受熱部と、筐体に設けられ、冷媒流路を有した放熱部と、受熱部の冷媒流路と放熱部の冷媒流路との間で液状の冷媒を流通する冷媒管50と、を有している。冷媒管の少なくとも一部は、他の部分に比較して、異なる内径、異なる断面形状、あるいは異なる本数の管路を有した異形部50cを構成している。

【選択図】 図9

出願人履歷情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日 2001年 7月 2日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名 株式会社東芝